

# H300-RB 抗RF系列

## 【导热硅胶垫片】规格书



-产品图-

### 应用特点：

- 柔软，可压缩性好
- 热阻抗较小
- 防火性能高
- 低介电常数和介质损耗
- 很好的电绝缘性能和耐温性能

### 应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 可穿戴设备

该系列产品符合RoHS、HSF、卤素管控标准。

### 储存条件：阴暗处储存

储存温度： $\leq 30^{\circ}\text{C}$

储存湿度： $\leq 70\%$

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

### 保质期：

在储存条件下：二年

不符合储存条件下：六个月

鸿富诚 H300-RB 导热硅胶垫片，该材料具有非常低的介电常数，保证信号传输中的延迟时间足够短，而不是阻碍信号传输，从而保证信号接收和传输的顺利进行，它广泛应用于网络通信设备。

### 产品性能

NO.	参数	单位	测试方法
颜色	白色	---	目视
厚度	1~4	mm	ASTM D 374
硬度	35~50( $\pm 5$ )	Shore C	ASTM D 2240
密度	1.5 $\pm$ 0.5	g/cc	ASTM D 792
拉伸强度	$\geq 0.15$	Mpa	ASTM D 412
压缩比	$\geq 20$ (@50psi)	%	ASTM D 695
阻燃等级	V-0	---	UL-94
使用温度	-50~160	$^{\circ}\text{C}$	IEC 60068-2-14

### 热学特性

导热系数	3.0 $\pm$ 0.5	W/m $\cdot$ K	ASTM D 5470
热阻	$\leq 1.2$ (@20Psi/1mm)	$^{\circ}\text{Cin}^2/\text{W}$	ASTM D 5470

### 电学特性

击穿电压	$\geq 10$	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	$\geq 10^{10}$	$\Omega\cdot\text{cm}$	ASTM D 257
介电常数	$\leq 3.5$	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	$\leq 0.002$	@1MHz	ASTM D 150

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权

